GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司



Global Family,
Global Solutions!

環球晶圓(6488TT)
2026年第二季營運報告

2026/08/04

Disclaimer

This presentation has been prepared by GlobalWafers Co., Ltd. (the “Company”). This presentation and the materials provided herewith do not constitute an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire securities of the Company in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity, nor may it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase securities in a proposed offering should be made solely on the basis of the information contained in the offering circular published in relation to such proposed offering, if any.

The information contained in this presentation has not been independently verified. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or the opinions contained herein. The information contained in this document should be considered in the context of the circumstances prevailing at the time and has not been, and will not be, updated to reflect material developments which may occur after the date of the presentation. None of the Company nor any of its affiliates, advisors or representatives will be liable (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation.

01

經營團隊重點報告

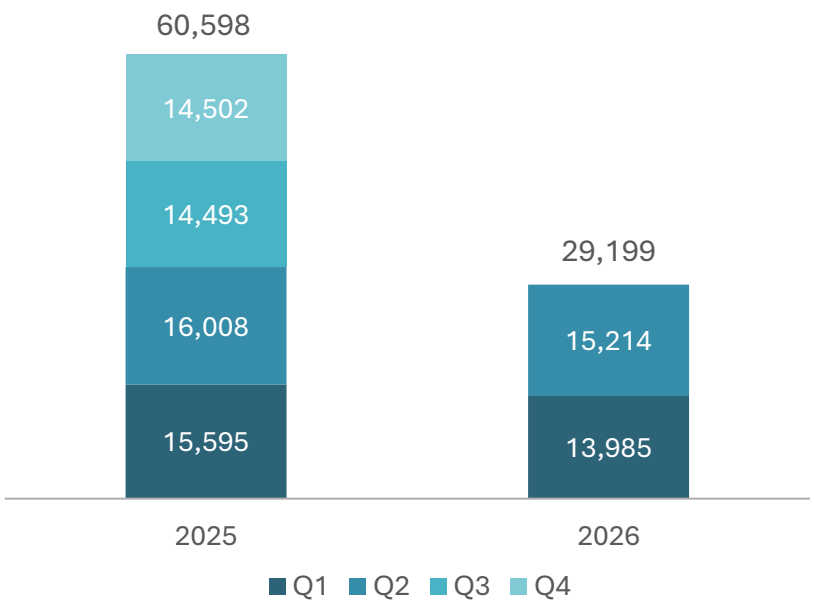
經營團隊重點報告

➢ 財務摘要

營業收入

- 2026年第二季→新台幣152億元，季增8.79%
- 2026年上半年→新台幣292億元，年減7.60%

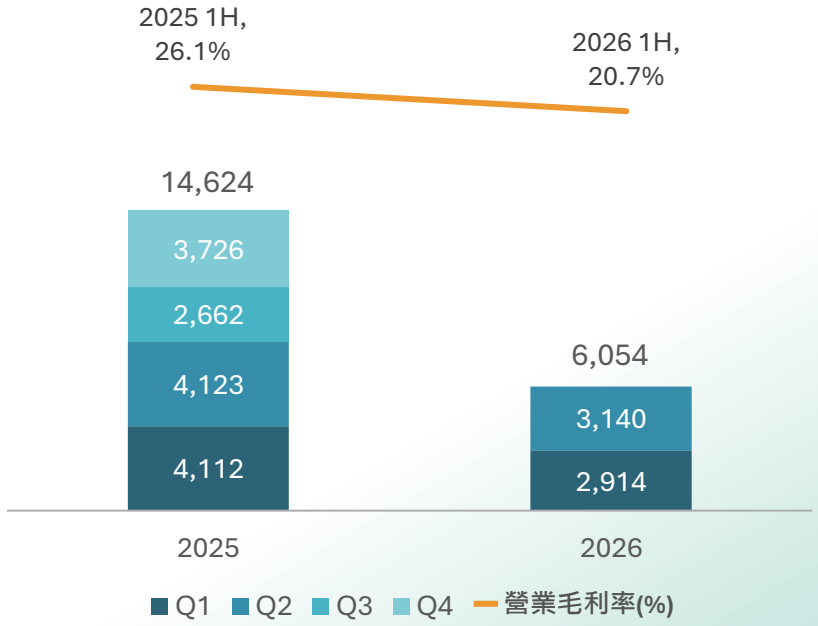
（新台幣百萬元）



營業毛利率

- 2026年第二季→20.6%
- 2026年上半年→20.7%

（新台幣百萬元）



© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

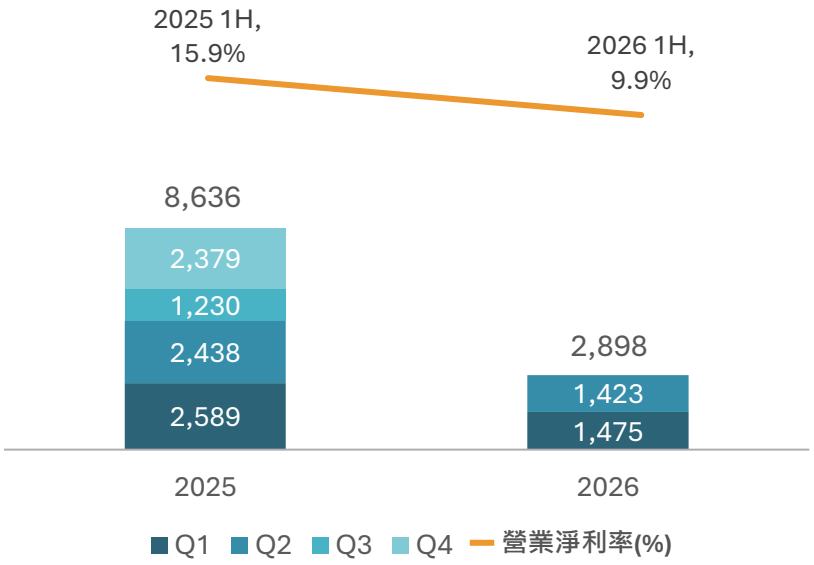
經營團隊重點報告

➢ 財務摘要

營業淨利率

- 2026年第二季→9.4%
- 2026年上半年→9.9%

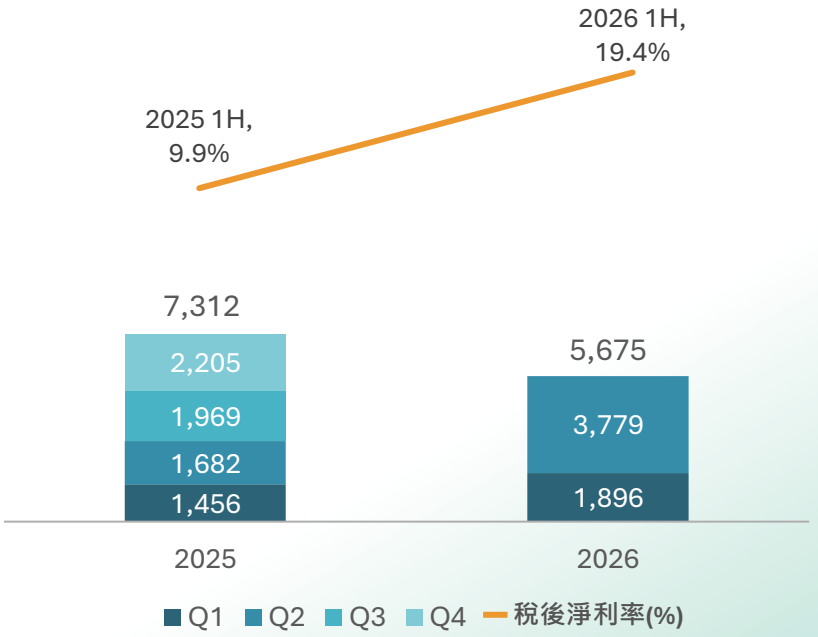
（新台幣百萬元）



稅後淨利率

- 2026年第二季→24.8%
- 2026年上半年→19.4%

（新台幣百萬元）



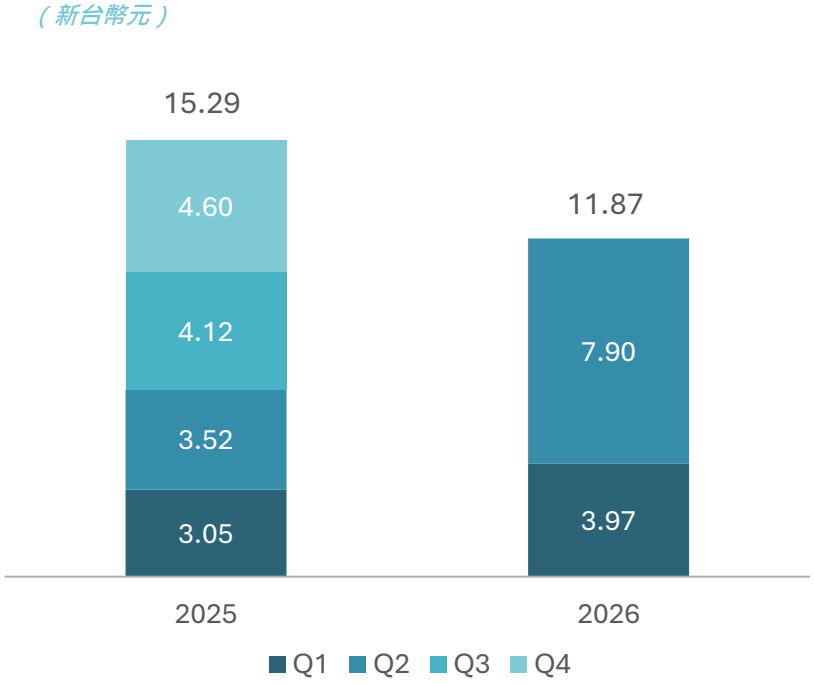
© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

經營團隊重點報告

➢ 財務摘要

每股盈餘

- 2026年第二季→新台幣7.90元
- 2026年上半年→新台幣11.87元



預收貨款

- 新台幣222億元（6.6億美元）[1]

備註：
匯率：新台幣兌美元 = 31.85，含保證金。

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

經營團隊重點報告

➢ 產業概況

■ 隨著 AI 需求擴及更多應用領域，市場展望有所改善，惟整體復甦仍呈漸進且不均衡

- ✓ **AI 需求具結構性成長動能**——全球主要雲端服務供應商持續上調 AI 相關資本支出預期，支撐中期強勁需求週期的能見度。隨著代理式AI（Agentic AI） 與雲端至邊緣（Cloud-to-Edge）運算架構持續發展，帶動運算及記憶體需求提升，成為半導體需求成長的重要驅動力。

- ✓ **復甦範圍持續擴大，但進程仍漸進且不均衡**——客戶庫存已逐步回歸健康水位，訂單能見度亦持續改善，復甦範圍擴展至更多終端應用。AI 需求亦逐步由先進製程延伸至部分成熟製程，帶動工業及電力等應用改善，同時推升新興應用領域的需求（如 AI 可穿戴設備、新世代通訊等）。

- ✓ **全球供應鏈重組正在重塑企業的優先考量**——在地緣政治不確定性持續影響全球供應鏈布局下，客戶更加重視供應穩定性、區域化生產及營運韌性。採購決策亦已由價格導向，逐步擴展至供應穩定性、在地化及低碳製造能力、產品可追溯性、再生能源供應能力，以及長期合作關係等多元考量。

- ✓ **技術演進持續推升高規格晶圓需求**——AI、高階封裝及先進製程持續演進，帶動晶圓使用量提升，並提高晶圓品質及驗證要求。部分高規格產品的供需仍然偏緊，主要因市場需求強勁，且具備合格先進晶圓生產能力的供應商數量有限。

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

經營團隊重點報告

➢ 產業概況

■ AI 驅動成長持續擴展至更多應用領域，環球晶圓可望受惠

- ✓ **營運動能增強，帶動稼動率持續提升**——除AI及先進製程需求維持強勁外，成熟製程相關應用，包括工業及電源管理等需求亦持續改善。既有12吋晶圓產線維持滿載（不含仍處於導入及量產爬坡階段之新增產能），8吋產線維持高稼動率，復甦動能亦逐步延伸至6吋產品。

- ✓ **全球擴產成果逐步顯現**——環球晶圓近年持續推動全球擴產策略，隨著新產能陸續完工並進入客戶驗證階段，公司現階段重點聚焦於客戶驗證、生產爬坡及營運效率優化。在產業基本面持續改善的帶動下，將有助於公司掌握成長機會，並進一步釋放新建及擴建廠區的營運效益。

- ✓ **全球製造布局優勢持續深化**——環球晶圓多元化的全球生產據點與客戶區域化布局相互配合，持續強化在地供應能力，並提升各主要市場的服務效率與回應速度。公司將依據客戶需求及產品驗證進度，靈活配置全球產能，並透過長期合作夥伴關係（包括近期宣布與美光（Micron）的策略合作），進一步提升供應穩定性及營運效率。

- ✓ **高附加價值產品布局持續推進**——絕緣體上矽（SOI）、氮化鎵（GaN）、12吋碳化矽（SiC）及方形晶片（square wafer）等高附加價值產品需求能見度良好。公司多數新建廠區均規劃生產高技術門檻晶圓產品，將有助於掌握未來高附加價值市場的成長機會。

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

半導體應用趨勢顯示成長具結構性支撐，超越景氣循環復甦



運算與AI基礎設施

結構性韌性

- AI 普及仍處於多年成長初期，主要雲端服務供應商今年持續上調 AI 相關資本支出計畫，支撐產業長期發展。
- 產業領導廠商持續投入先進製程產能擴充，以因應未來 AI 推論（inference）及雲端與邊緣運算需求成長，進一步支撐對先進矽晶圓產品的長期需求。
- 代理式 AI（Agentic AI）正推動數據中心架構演進，除 AI 加速器之外，也帶動更多 CPU 運算資源需求，提高矽晶圓需求。



記憶體市場

基本面穩健

- 儘管產能擴充持續進行，在有利的產業環境支持下，未來數年市場供應仍將維持相對緊俏。
- 客戶透過長期供應協議確保供貨來源，進一步提高近中期晶圓需求的能見度。
- HBM 採用率持續提升，加上記憶體技術複雜度不斷增加，帶動更多晶圓需求，並支撐矽晶圓需求的持續成長。



智慧型手機與個人電腦

需求逐步趨穩

- AI 功能導入及高階裝置占比提升，持續增加單機半導體含量，進而帶動高價值邏輯、記憶體及射頻元件需求。
- 既有裝置逐漸老化，加上具備 AI 功能的智慧型手機與個人電腦陸續推出，預期將帶動為期多年的裝置換機週期，進一步強化半導體的長期需求。

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

半導體應用趨勢顯示成長具結構性支撐，超越景氣循環復甦（續）

車用與工業應用

漸進復甦，矽含量不斷提高

- 電源與工業應用市場需求持續改善；車用半導體市場需求則隨著庫存逐步正常化。單一車輛半導體含量持續提升，支撐中期需求成長。
- ADAS、軟體定義汽車（SDV）及智能汽車架構的發展，帶動邏輯、感測器、功率及連網 / 通訊半導體需求增加。
- 對機器人與實體AI技術的持續投資，成為推動邏輯、記憶體、感測器及功率元件需求的額外長期成長動能，並進一步支撐整體矽晶圓需求。

先進封裝

基本面穩健

- 隨著晶片廠商在複雜架構中整合更多晶粒與元件，CoWoS、CoPoS、Wafer-on-Wafer 及 HBM 堆疊等封裝技術日益成為提升AI系統效能的關鍵技術。
- 這些技術需要更多晶圓層數、更嚴格的規格要求以及更複雜的製造流程，而較低的良率也可能進一步提高每套系統所需的晶圓數量，進而支撐先進及特殊規格晶圓的需求。

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

02

公司概况

AI 基礎建設投資推動晶圓需求的結構性成長

AI 資本支出持續增加

- 2026 年第二季 AI 需求維持強勁，企業導入持續推進，加上 AI 應用情境持續擴展，進一步支撐相關資本投資。
- 市場共識預估主要雲端服務供應商於 2026 至 2029 年的累計 AI 資本支出將較 2025 年 12 月預估增加約 1.3 兆美元（+58%），進一步強化對先進半導體製造投資的持續需求。

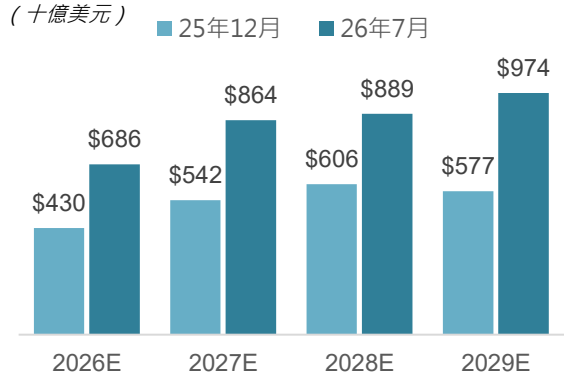
半導體產能持續擴張

- 主要半導體製造商持續擴充先進邏輯及 HBM 產能，隨著新生產線逐步邁向量產，進一步支撐長期晶圓需求。
- 美國、日本、韓國及歐洲等地的產能擴張，反映半導體製造商的在地化策略，同時強化各區域半導體製造生態系統。

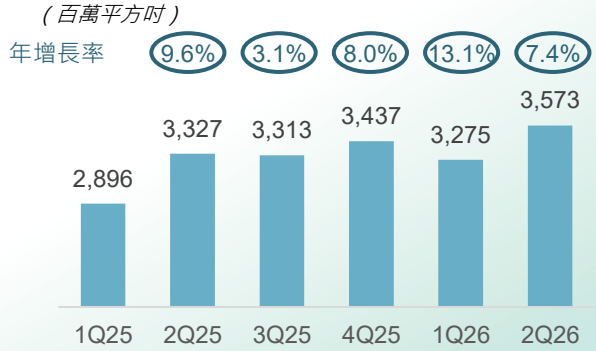
持續性晶圓需求利好環球晶圓

- AI 驅動的產能擴張持續轉化為對環球晶圓矽晶圓產品組合的穩定需求。
- 環球晶圓全球生產據點維持高稼動率，反映客戶需求健康且新增產能持續爬坡。
- 與客戶的長期合作關係持續提升未來晶圓需求的能見度。

不同日期節點美國主要雲端服務供應商資本支出預估[1]



全球矽晶圓出貨量



資料來源：公司文件、SEMI矽晶圓出貨統計（2026年7月）、FactSet（截至2026年7月18日）。
備註：1.此處為亞馬遜、Meta、微軟、Alphabet和甲骨文五家公司之合計數據。

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

新興應用正擴大矽晶圓、SOI 及化合物半導體晶圓需求

AI 穿戴裝置與邊緣運算

- AI 推論正逐步擴展至邊緣裝置及邊緣運算，帶動低功耗感測、連接及電源管理技術以及高效能邊緣運算晶片需求增加。
- SOI、GaN 、 SiC 、先進磊晶晶圓與拋光晶圓的採用持續提升，以支援感測及 MicroLED 顯示應用（例如 AR 眼鏡）。

AI 伺服器與封裝

- 代理型 AI 帶動 CPU、ASIC 、GPU、HBM 及功率半導體的廣泛需求，進一步提高晶圓使用量。
- AI 功率密度提升，加速 SiC 熱管理技術及 GaN 電源技術與先進封裝方形面板的採用。
- GaN 功率元件市場預計於 2030年達到約 30 億美元規模，自 2024 年起年複合成長率約為 42%。

次世代通訊

- AI 運算叢集愈來愈依賴高速光學互連技術，進而帶動矽光子的結構性需求。
- 矽光子基板 (Photonics-SOI) 需求高速成長，年複合成長率超過 35%。

電氣化與自動化

- 電氣化、機器人及工業自動化發展，正加速 SiC 、 GaN 功率半導體和功率SOI (Power-SOI) 的採用。
- 更高電壓及更高效率的系統需求，推動次世代化合物半導體材料的應用。
- SiC 功率元件市場預計於 2031 年達到約 110 億美元規模，自 2025 年起年複合成長率約為20%。

AI應用持續擴展，帶動先進晶圓、特殊規格晶圓及成熟製程晶圓需求成長

產品組合優化
SOI 、化合物半導體晶圓及方形面板晶片的採用加速，有助於提升高附加價值產品組合比重

更廣泛的出貨量成長
類比、功率及工業半導體需求持續成長，帶動 12吋、8 吋及 6 吋晶圓需求進一步提升

長期成長
更廣泛的終端市場佈局，有助於支撐更多元化且可持續的長期成長

資料來源：Yole Group（2025年10月與2026年6月）；Kaiso Research（2026年6月）。

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

環球晶圓在地化製造佈局契合客戶產能擴張需求

- 環球晶圓的全球製造佈局高度契合客戶在地化供應需求，從而實現更緊密的客戶合作並增強各區域供貨韌性，更有力地支援客戶在可追溯性和永續性方面的要求。
- 在地化製造有效加強與客戶的策略合作關係，例如環球晶圓於 2026 年 7 月宣布與美光科技（Micron Technology, Inc.）展開長期合作，以支持美國晶圓供應鏈在地化。
- 環球晶圓擴產成果開始顯現。隨著新增產能開始挹注營收與獲利，營運重心亦由廠房建置轉向客戶認證及產能爬坡。

	製造基地	狀態	生態系能力亮點
持續擴產	美國德州謝爾曼市（Sherman, Texas）	■ 已完成多家客戶認證 ■ 持續製程優化	領先半導體製造商宣布在美投入超過6,000 億美元用於擴產，支撐在地化製造需求
	美國密蘇里州聖彼得斯市（St. Peters, Missouri）	■ 客戶送樣與驗證持續進行 ■ 射頻絕緣體上矽（RF-SOI）和矽光子（Silicon Photonics）產品已進入小量生產	領先半導體製造商宣布投入超過 100 億美元，鞏固對特殊晶圓（包括SOI）的長期需求
	義大利諾瓦拉（Novara）	■ 首批客戶認證進展順利 ■ 後續將依客戶認證進度及市場需求，穩步提升產能利用率	領先半導體製造商宣布投入超過 100 億美元，有助於歐洲的功率半導體生態系統發展完善
近期完成	日本宇都宮（Utsunomiya）	■ 擴產已順利完成，新增產能全數到位 ■ 整體產能利用率維持高檔 ■ 營運及財務表現持續改善	領先半導體製造商宣佈投入超過300 億美元，帶動日本先進半導體製造產業發展

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

半導體技術發展藍圖持續提升矽晶圓用量與價值

重點技術轉型領域	範例
先進封裝架構提高每套系統的晶圓使用量 ■ Wafer-on-Wafer（晶圓對晶圓堆疊）、CoWoS、HBM 堆疊及矽中介層等技術，因需要更大的矽面積，使每套終端系統所需的晶圓用量顯著增加	代表性 AI 加速器架構： 2.5D 與 3D 多晶粒封裝相較於傳統單晶片設計， 單位元件面積上需要更大的矽面積，進而提升矽晶圓用量
HBM 技術使每套系統所需的晶圓用量結構性提升 ■ 相較於傳統 DRAM，較大的晶粒尺寸與 TSV 3D 堆疊架構，使每單位記憶體容量所需的矽用量增加	
先進製程微縮提升晶圓製造複雜度與價值 ■ FinFET 朝 GAA 與 晶背供電 演進，對矽晶圓規格及製造公差要求更加嚴格 ■ 晶圓鍵結的需求增加，特殊矽晶圓參數要求因應而生	隨著量測與製造新設備的投入需求持續增加， 推動產學合作、與設備商共同開發及自主研發，三軌並進
先進製程演進持續提升晶圓價值 ■ 先進製程製造需要更高的純度、平坦度、缺陷控制能力及其他特殊需求的矽晶圓，使高規格矽晶圓具備更高的產品價值	先進製程所需之矽晶圓產品價值， 遠高於成熟製程所需之矽晶圓的產品價值

環球晶圓差異化的技術組合與半導體技術發展趨勢高度契合

12吋SOI
- 在矽光子需求持續成長帶動下，SOI 產能持續放量，供不應求

氮化鎵 GaN
- 產能利用率維持滿載，擴產持續推進（約 30% 已完成、約 20% 正在進行中）

碳化矽 SiC
- 12 吋 SiC 持續進行多家客戶驗證，為未來商業化奠定基礎

方形晶片
- 多家客戶驗證作業進展順利

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

03

營運概況

財務摘要：2026年第二季 vs. 2026年第一季 vs. 2025年第二季

(單位: 新台幣百萬元，除每股盈餘)	2026年第二季	2026年第一季	2025年第二季	季成長	年成長
營業收入	15,214	13,985	16,008	8.8%	-5.0%
營業毛利 %	20.6%	20.8%	25.8%	-0.2p.p.	-5.2p.p.
營業淨利	1,423	1,475	2,438	-3.6%	-41.6%
營業淨利 %	9.4%	10.5%	15.2%	-1.1p.p.	-5.8p.p.
本期淨利	3,779	1,896	1,682	99.3%	124.7%
本期淨利 %	24.8%	13.6%	10.5%	11.2p.p.	14.3p.p.
每股盈餘[1]	NT$7.90	NT$3.97	NT$3.52	NT$3.93	NT$4.38
EBITDA[2]	6,969	4,060	4,472	71.6%	55.9%
EBITDA %	45.8%	29.0%	27.9%	16.8p.p.	17.9p.p.
EBIT[3]	4,556	1,855	2,027	145.5%	124.8%
股東權益報酬率 (ROE[4] (年化))	15.9%	8.1%	7.6%	7.8p.p.	8.3p.p.
資產報酬率 (ROA[5](年化))	8.15%	4.17%	3.40%	3.9p.p.	4.7p.p.
資本支出[6]	2,202	3,460	7,537	-	-
折舊費用	2,408	2,199	2,440	-	-

備註: 1. EPS = 歸屬於母公司淨利 / 期間內平均已發行普通股數量
2. EBITDA = 本期淨利+所得稅+利息+折舊費用+攤銷費用
3. EBIT = 本期淨利 + 所得稅 + 利息
4. ROE = 本期淨利 / 股東平均權益
*5. ROA = ((本期淨利+利息費用 * (1-有效稅率)) / 平均資產*
6. Capex = 期末取得不動產、廠房及設備及預付設備款 - 期初取得不動產、廠房及設備及預付設備款

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

財務摘要： 2026年上半年 vs. 2025年上半年

(單位: 新台幣百萬元，除每股盈餘)	2026年上半年	2025年上半年	年成長
營業收入	29,199	31,602	-7.6%
營業毛利 %	20.7%	26.1%	-5.4p.p.
營業淨利	2,898	5,027	-42.4%
營業淨利 %	9.9%	15.9%	-6.0p.p.
本期淨利	5,675	3,138	80.9%
本期淨利 %	19.4%	9.9%	9.5p.p.
每股盈餘[1]	NT$11.87	NT$6.56	NT$5.31
EBITDA[2]	11,029	8,505	29.7%
EBITDA %	37.8%	26.9%	10.9p.p.
EBIT[3]	6,411	3,804	68.5%
股東權益報酬率 (ROE[4] (年化))	11.9%	7.1%	4.8p.p.
資產報酬率 (ROA[5](年化))	6.05%	3.2%	2.9p.p.
資本支出[6]	5,662	19,094	-
折舊費用	4,607	4,689	-

備註: 1. EPS = 歸屬於母公司淨利 / 期間內平均已發行普通股數量
2. EBITDA = 本期淨利+所得稅+利息+折舊費用+攤銷費用
3. EBIT = 本期淨利 + 所得稅 + 利息
4. ROE = 本期淨利 / 股東平均權益
*5. ROA = ((本期淨利+利息費用 * (1-有效稅率)) / 平均資產*
6. Capex = 期末取得不動產、廠房及設備及預付設備款 - 期初取得不動產、廠房及設備及預付設備款

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司

損益表

新台幣百萬元	2025	Q126	Q226	1H26	1H26（模擬）[1]
營業收入	**60,598**	**13,985**	**15,214**	**29,199**	**27,502**
成長率(%)	*-3.2%*	*-3.6%*	*8.8%[2]*	*-7.6%*	*-*
營業毛利	**14,624**	**2,914**	**3,140**	**6,054**	**8,918**
營業毛利率(%)	*24.1%*	*20.8%*	*20.6%[3]*	*20.7%[4]*	*32.4%*
EBITDA	**17,340**	**4,060**	**6,969**	**11,029**	**10,433**
EBITDA率(%)	*28.6%*	*29.0%*	*45.8%*	*37.8%*	*37.9%*
營業淨利	**8,636**	**1,475**	**1,423**	**2,898**	**6,214**
營業淨利率(%)	*14.3%*	*10.5%*	*9.4%*	*9.9%*	*22.6%*
稅前淨利	**9,516**	**2,347**	**4,585[5]**	**6,932**	**6,825**
稅前淨利率(%)	*15.7%*	*16.8%*	*30.1%*	*23.7%*	*24.8%*
稅後淨利	**7,312**	**1,896**	**3,779[5]**	**5,675**	**5,384**
稅後淨利率(%)	*12.1%*	*13.6%*	*24.8%*	*19.4%*	*19.6%*
每股盈餘（NT$）	**15.29**	**3.97**	**7.90[5]**	**11.87**	**11.26**

備註: 1. 模擬數係排除美國、義大利和日本的重大擴產計畫與持有 Siltronic 股份的市值變動影響
2. 2026 年第二季營收季增率（QoQ）
3. 2026年第二季毛利率儘管營收成長，仍較前一季大致持平，主要反映折舊增加、獎酬提列，以及運費與能源費用上升影響。
4. 2026年上半年營業毛利率較去年同期下降，主要反映折舊費用增加及其他擴產相關成本
5. 2026年第二季稅前淨利、稅後淨利及每股盈餘較前一季增加，主要受 Siltronic 持股按市價評價利益挹注

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

資產負債表

新台幣百萬元	2024	2025	Q126	Q226
資產				
現金及約當現金	38,929	19,484	24,128	23,776
應收帳款	10,265	10,113	10,138	10,548
存貨	11,238	10,399	11,000	12,015[3]
不動產、廠房及設備	119,074	107,241	108,861	107,864
其他資產	45,074	71,105	56,910	65,017
資產總計	**224,581**	**218,343**	**211,037**	**219,220**
負債				
短期借款[1]	28,797	31,010	33,887	38,282[4]
應付帳款	5,371	4,161	3,867	4,697
長期借款[2]	37,678	43,244	29,221	33,188[4]
其他負債	61,706	46,632	50,683	46,333
負債總計	**133,553**	**125,048**	**117,657**	**122,500**
權益總計	**91,028**	**93,295**	**93,379**	**96,720**

現金資產細項包含:	
(新台幣百萬元)	**Q226**
三個月以上定存	4,768
受限制現金	18,019
債券	6,338

備註: 1. 短期借款包括短期借款、應付短期票券，以及一年內或一營業週期內到期的長期借款、應付公司債與應付可轉換公司債
2. 長期借款包括長期借款、應付公司債及應付海外附認股權公司債
3. 2026年第二季存貨較前季增加，主要因應預期下半年需求而提前備貨
4. 2026年第二季短期及長期借款較前季增加，主要反映全球資金管理，以及營運與擴產的資金需求

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

04

ESG

環境保護 – SBTi

- 環球晶圓的近期與長期溫室氣體減量目標已於 2026 年 5 月通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）審查，進一步推動公司朝 2050 年淨零排放目標邁進。環球晶圓正透過營運優化、擴大再生能源使用，以及深化與供應商合作，加速推動減碳行動，以支持更低碳且更具可追溯性的供應鏈。

科學基礎減量目標與減碳策略



於 2050 年實現全價值鏈淨零排放

範疇	近期目標 (2035)	長期目標 (2050)
範疇一與範疇二 (2022 為基準年)	減碳 63%	減碳 90%
範疇三 (2024 為基準年)	**減碳 37.5%** *(類別 1–3)*	**減碳 90%** *(全類別)*



製程與設備優化



擴大再生能源使用



供應商碳足跡評估



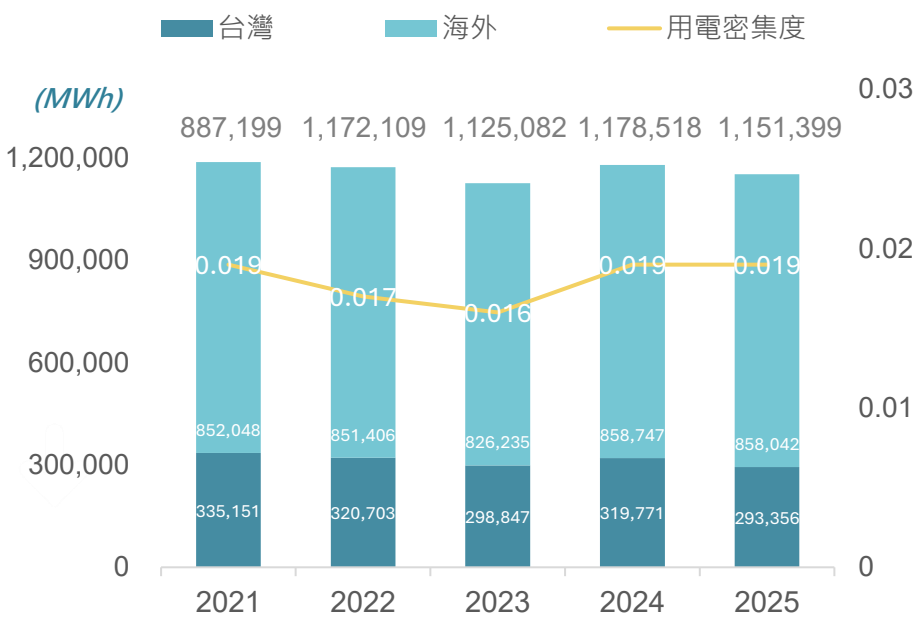
與關鍵供應商
進行SBTi議合，推動
供應鏈減碳

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

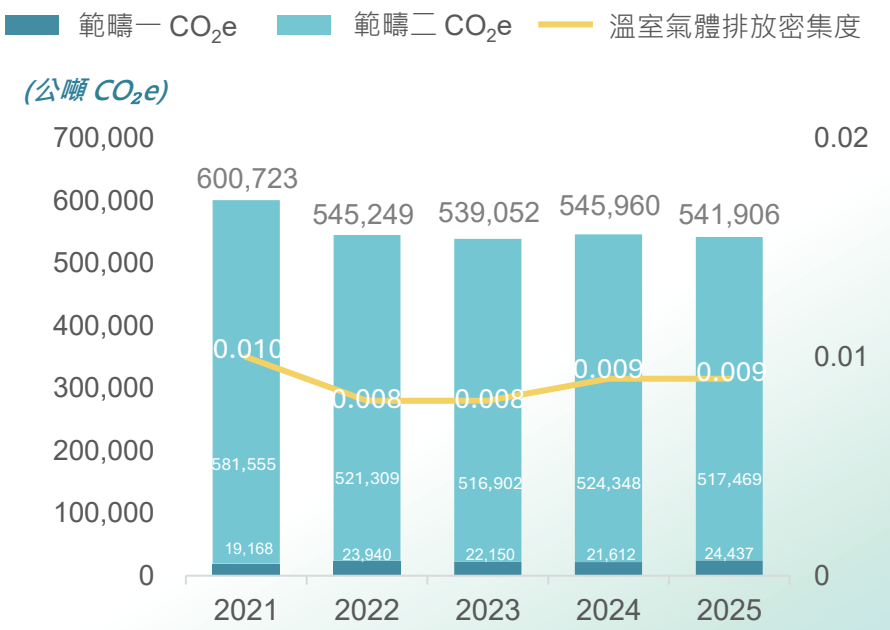
環境保護 – 溫室氣體 & 用電

- **用電量:** 2025 年總用電量維持於約 115 萬MWh ，維持穩定，用電密集度則維持在 0.019，展現環球晶圓在全球業務持續擴展之際，仍持續重視營運效率管理。
- **溫室氣體排放:** 2025 年範疇一及範疇二溫室氣體排放總量約為 54.2 萬公噸 CO_2e，排放密集度則維持於 0.009，反映環球晶圓在排放管理方面持續取得進展，並穩步推動長期減碳策略。

用電量 & 用電密集度[1], 2021-2025



溫室氣體排放 & 密集度[2] (範疇一&二), 2021-2025



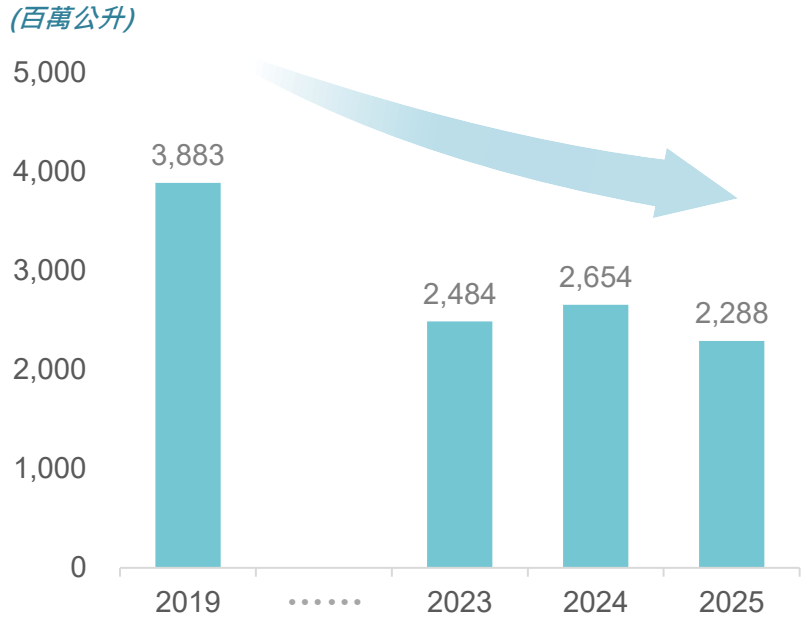
備註: 1. 用電密集度 = MWh / 合併營收 (新台幣千元)
2. 溫室氣體排放密集度 = 二氧化碳當量公噸 / 合併營收 (新台幣千元)

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

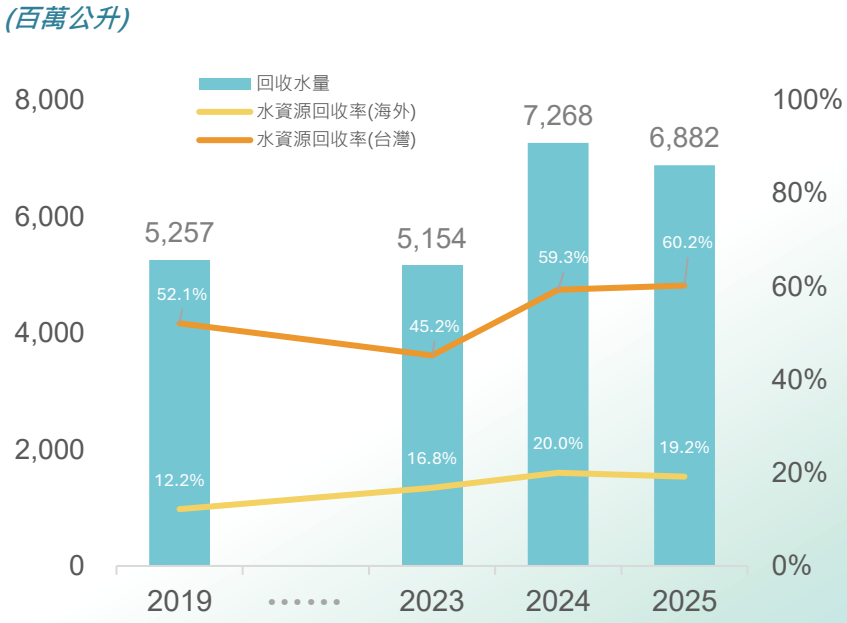
環境保護 – 水資源管理

- **耗水量:** 2025年耗水量降至2,288百萬公升（megaliters），較前一年減少13.8%，較2019年減少約41%，反映公司持續推動節水措施及提升製程效率的成果。
- **水資源回收:** 2025年回收水量維持 6,882 百萬公升的高水準。台灣廠區的水回收率近年持續提升，2025年達60.2%，為近年來最高，展現環球晶圓持續提升水資源再利用效益並推動循環經濟實踐的成果。

耗水量, 2019-2025



水資源回收, 2019-2025

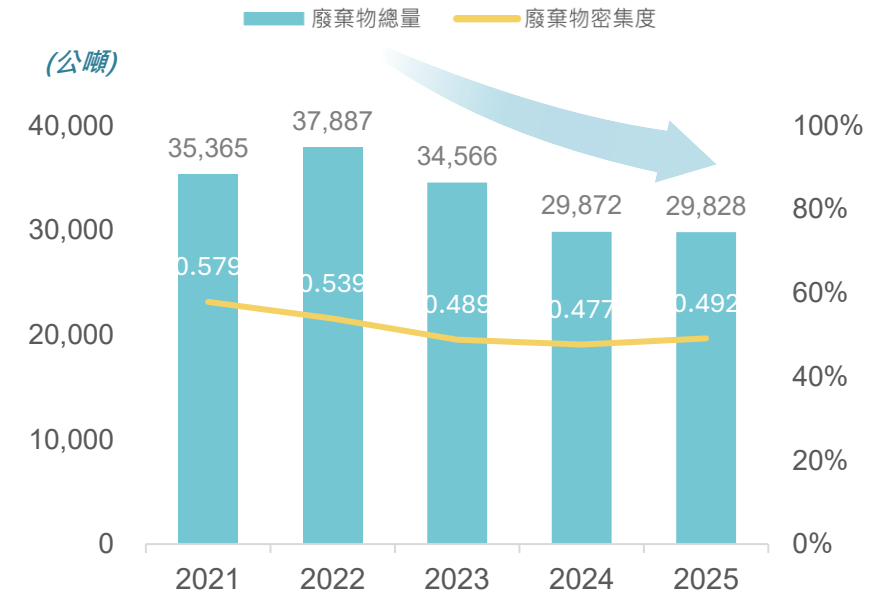


© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

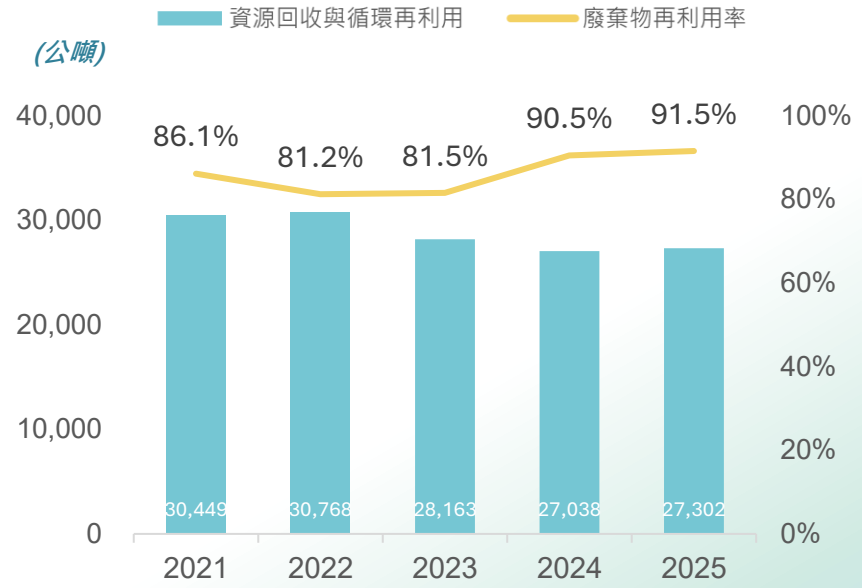
環境保護 – 廢棄物

- **廢棄物總量:** 2025年廢棄物總量約為2.99萬公噸，整體維持穩定；廢棄物密集度則維持低於2021年的水準，反映環球晶圓持續致力於廢棄物減量及提升營運效率。
- **廢棄物回收:** 2025年廢棄物再利用率連續第三年提升，達91.5%，創近年新高，展現環球晶圓在資源回收、廢棄物循環再利用及循環經濟實踐方面持續取得進展。

廢棄物總量 & 廢棄物密集度[1], 2021-2025



廢棄物回收再利用, 2021-2025



備註: 1. 廢棄物密集度 = 公噸 / 合併營收 (新台幣百萬元)

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

生物多樣性行動：保護海洋與都市生態系統

- 環球晶圓將生物多樣性納入環境管理，並於海洋與都市生態系統推動符合在地需求的相關行動。這些行動展現公司持續致力於棲地保護、提升生態韌性，並支持生物多樣性長期保育的努力。

已清除海洋及海岸廢棄物

7,011 公斤

3 座都市綠地

海洋生態系統保護

- 透過與 Ogyre 為期三年的合作，環球晶圓義大利子公司支持當地漁業社群於義大利、巴西、印尼及塞內加爾清除海洋廢棄物。
- 此項行動有助於減輕海洋棲地所承受的壓力，並支持更健康且更具韌性的沿海生態系統。



都市生物多樣性倡議

- 自 2026 年 1 月起，環球晶圓義大利子公司 SPA 透過由諾瓦拉市政府推動的「Novara City in Green」計畫，支持三處都市綠地之管理維護。
- 該計畫有助於營造友善授粉昆蟲的棲地，進一步提升都市生物多樣性及生態韌性。



© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

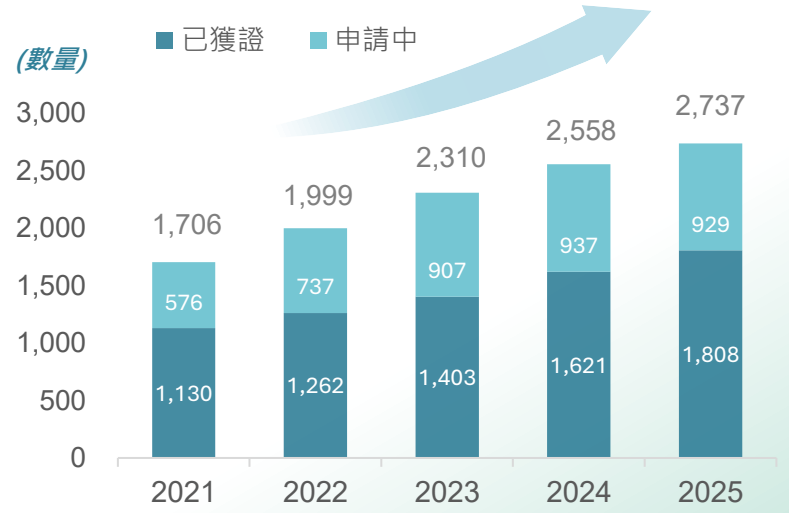
ESG 亮點: 公司治理

- 環球晶圓持續因卓越的公司治理表現獲得外部肯定。公司連續第八年榮獲櫃買中心公司治理評鑑前5%，並連續第四年入選FTSE4Good 富時社會責任指數系列成分股。
- 環球晶圓亦持續強化創新研發及智慧財產實力。2025年，集團累計持有2,737件有效專利，涵蓋第一代至第三代半導體技術領域；同時連續第五年名列台灣百大本國法人專利申請人，並連續第六年取得台灣智慧財產管理制度（TIPS）AA級驗證。

公司治理成就

- 上櫃公司治理評鑑前5% (連續第8年)
- FTSE4Good 指數成分股 (連續第4年)
- 台灣百大本國法人專利申請人 (連續第5年)
- 台灣智慧財產管理制度 (TIPS) AA級驗證 (連續第6年)
- 新竹科學園區研發成效獎

有效專利 (集團總數, 2021–2025)



© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

2026 全球社區參與

- 環球晶圓於亞洲、歐洲及美洲各地，透過慈善捐助、員工志工服務、STEM 教育推廣及社區關懷活動支持在地社區，為營運據點所在地區創造正向社會影響。這些行動共同強化社區連結、回應在地需求，並有助於打造更具包容性與韌性的社區。

2026年全球營運據點之社區參與行動

美洲
啟發未來人才




- 支持科學、科技、工程與數學 (STEM) 領域的人才發展
- 建立跨產業女性專業人才交流網絡

亞洲
社區行動





- 於兒童福利中心提供志工服務
- 共同舉辦捐血活動

歐洲
關懷與付出




- 支持兒童癌症基金會
- 捐贈玩具予有需要的兒童

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

05

Q&A